

2009年3月期 第2四半期決算に関する補足資料

億円未満は切捨て表示しています

1. 決算概要

(連結)

	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9		2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		増減率
売上高	2,638	100.0%	1,463	100.0%	44.5%
売上総利益	887	33.6%	389	26.6%	56.1%
営業利益	519	19.7%	48	3.3%	90.7%
経常利益	546	20.7%	66	4.5%	87.8%
税前列利益	557	21.1%	64	4.4%	88.4%
当期純利益	362	13.7%	45	3.1%	87.6%

単位:億円

	2008年3月期 第2四半期累計 2007.4-2007.9		2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		増減率
	4,763	100.0%	3,012	100.0%	36.8%
	1,653	34.7%	910	30.2%	44.9%
	950	19.9%	262	8.7%	72.3%
	957	20.1%	289	9.6%	69.8%
	982	20.6%	286	9.5%	70.8%
	624	13.1%	173	5.8%	72.2%

2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9		2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		増減率
半導体製造装置					
国内	630		333		47.0%
米国	313		160		49.0%
欧州	65		69		6.4%
韓国	196		117		40.1%
台湾	794		131		83.4%
中国	66		32		51.5%
東南アジア他	67		116		71.9%
海外計	1,504		627		58.3%
計	2,134		961		55.0%
FPD製造装置					
国内	128		24		81.1%
韓国	57		107		86.1%
台湾	15		67		333.3%
中国・東南アジア	20		30		51.3%
海外計	93		204		119.8%
計	222		229		3.2%
電子部品・情報通信機器					
国内	254		235		7.2%
海外	26		36		35.0%
計	280		272		3.2%
その他					
国内	1		1		2.1%
海外	-		-		-
計	1		1		2.1%
連結合計					
国内	1,014		594		41.3%
海外	1,624		869		46.5%
計	2,638		1,463		44.5%

単位:億円

	2008年3月期 第2四半期累計 2007.4-2007.9		2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		増減率
	946		662		30.0%
	524		349		33.5%
	144		148		2.7%
	411		266		35.2%
	1,419		388		72.6%
	205		70		65.8%
	141		201		42.6%
	2,846		1,424		50.0%
	3,792		2,087		45.0%
	237		62		73.8%
	121		170		40.1%
	56		115		105.1%
	20		54		159.5%
	198		339		71.0%
	436		401		7.8%
	485		461		5.0%
	47		59		26.8%
	532		521		2.2%
	2		2		14.4%
	-		-		-
	2		2		14.4%
	1,671		1,188		28.9%
	3,092		1,823		41.0%
	4,763		3,012		36.8%

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

(連結)

	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9		2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		増減率
産業用電子機器					
売上高	2,360		1,194		49.4%
営業費用	1,850		1,155		37.6%
営業利益	510		39		92.3%
電子部品・情報通信機器					
売上高	283		273		3.5%
営業費用	274		264		3.5%
営業利益	9		9		1.5%
消去又は全社					
売上高	5		4		-
営業費用	5		4		-
営業利益	0		0		58.3%
連結					
売上高	2,638		1,463		44.5%
営業費用	2,119		1,415		33.2%
営業利益	519		48		90.7%

単位:億円

	2008年3月期 第2四半期累計 2007.4-2007.9		2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		増減率
	4,236		2,496		41.1%
	3,304		2,249		31.9%
	931		246		73.5%
	538		524		2.6%
	519		508		2.2%
	18		15		12.3%
	10		8		-
	11		8		-
	0		0		23.9%
	4,763		3,012		36.8%
	3,813		2,749		27.9%
	950		262		72.3%

4. 受注高

(連結)

	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9	2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9	増減率
半導体製造装置	1,202	837	30.3 %
FPD製造装置	73	217	196.1 %
電子部品・情報通信機器	260	254	2.1 %
その他	1	1	2.1 %
合 計	1,537	1,311	14.7 %

単位:億円

	2008年3月期 第2四半期累計 2007.4-2007.9	2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9	増減率
	2,654	1,565	41.0 %
	114	536	366.9 %
	535	515	3.8 %
	2	2	14.4 %
	3,308	2,620	20.8 %

5. 受注残高

(連結)

単位:億円

	2008年3月期 第2四半期 2007.9末	2009年3月期 第2四半期 2008.9末	増減率
半導体製造装置	2,931	1,325	54.8 %
FPD製造装置	331	1,406	324.7 %
電子部品・情報通信機器	144	126	12.2 %
合 計	3,407	2,857	16.1 %

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位:億円

	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9	2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9	増減率
設備投資額	57	48	14.9 %
減価償却実施額	51	56	9.1 %
研究開発費	170	170	0.4 %

	2008年3月期 第2四半期累計 2007.4-2007.9	2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9	増減率
	127	104	18.2 %
	98	107	9.6 %
	319	315	1.2 %

- * 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。利益率及び対前年増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。

2009年3月期業績予想修正に関する補足資料

1. 2009年3月期業績予想修正概要

億円未満は切り捨て表示しています

(連結)

単位: 億円

	2008年3月期実績		2009年3月期第2四半期累計実績			2009年3月期予想			
	第2四半期累計	通期	第2四半期累計	利益率	対前年同期増減率	通期前回予想 8/8	通期修正予想 10/31	通期 利益率	対前年同期増減率
売上高	4,763	9,060	3,012	100.0%	36.8%	6,300	5,400	100.0%	40.4%
営業利益	950	1,684	262	8.7%	72.3%	510	120	2.2%	92.9%
経常利益	957	1,727	289	9.6%	69.8%	550	165	3.1%	90.4%
税前利益	982	1,692	286	9.5%	70.8%	550	160	3.0%	90.5%
当期純利益	624	1,062	173	5.8%	72.2%	330	80	1.5%	92.5%
単位: 円									
一株当たり配当金	70	125	20	-	-	40	24	-	-

2. 部門別 売上高

(連結)

単位: 億円

	2008年3月期実績		2009年3月期第2四半期累計実績			2009年3月期予想			
	第2四半期累計	通期	第2四半期累計	構成比	対前年同期増減率	通期前回予想 8/8	通期修正予想 10/31	通期 構成比	対前年同期増減率
半導体製造装置	3,792	7,264	2,087	69.3%	45.0%	4,205	3,440	63.7%	52.6%
FPD製造装置	436	680	401	13.3%	7.8%	960	925	17.1%	36.0%
電子部品・情報通信機器	532	1,111	521	17.3%	2.2%	1,130	1,030	19.1%	7.4%
その他	2	4	2	0.1%	14.4%	5	5	0.1%	10.0%
合計	4,763	9,060	3,012	100.0%	36.8%	6,300	5,400	100.0%	40.4%

3. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位: 億円

	2008年3月期実績		2009年3月期		
	第2四半期累計	通期	第2四半期累計 実績	通期前回予想 8/8	通期修正予想 10/31
設備投資額	127	227	104	200	200
減価償却実施額	98	214	107	230	230
研究開発費	319	660	315	620	630

4. 期末人員

単位: 人

	2008年3月期実績		2009年3月期		
	第2四半期末	期末	第2四半期末	期末前回計画 8/8	期末修正計画 10/31
国内	7,691	7,789	7,984	7,900	7,900
米国	1,367	1,281	1,264	1,250	1,250
欧州	455	450	407	450	400
アジア	878	909	911	900	900
連結計:	10,391	10,429	10,566	10,500	10,450

* 2009年3月期 予算作成の前提レート: US\$1 = ¥105

* 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

* 利益率、対前年増減率及び構成比については、1円単位の金額をもとに計算しています。